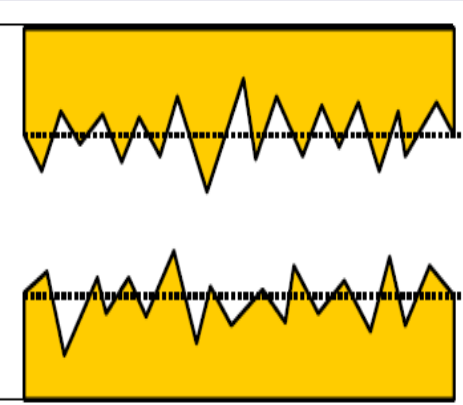
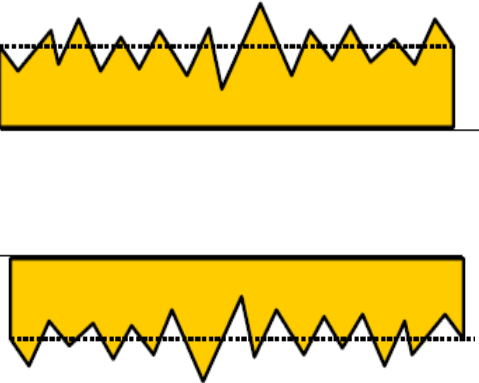


동박 종류	설명	Strong point	Weak point	Remark
	<p>HTE : Prepreg와 동박의 접착력을 강화하기 위해서, 동박의 Rough Side가 안쪽으로 구성된 제품 보통 육안상 동박 표면이 빛남 Shiny side</p>	<p>Prepreg 와 동박 사이의 결합력이 높음으로 가장 범용적인 CCL이며, 신뢰성이 높음</p>	<p>외층 작업시 표면 전처리 필요, 외층 미세 회로 구현시, Tail 형성에 대한 약점으로 Open Short 확률이 높음.</p>	<p>Nelco에 생산하는 90% 이상의 CCL이 HTE 제품 → 범용 제품</p>
	<p>RTF : CCL의 특성 조건을 만들기 위해, Rough side을 외각으로 향하게 구성된 제품, 보통 육안상 투박한 빛을 보임.</p>	<p>외층 전처리 필요 없음, 미세 회로 구현시 HTE 보다 상대적으로 좋음.</p>	<p>핸들링 주의 필요, 동박과 Prepreg 사이의 결합력이 약함.</p>	<p>Low Dk, Low Df의 Network 보드용 CCL의 경우, 현재 RTF로 전환하려는 움직임, 전체적으로 회로 관습이 적음</p>